

2003年5月28日

## 最新の POWER4 + プロセッサを最大 2 個搭載可能な エントリーモデル「EP8000 615 model 6C3/6E3」を販売開始

処理性能を約 1.5 倍に向上し、高信頼化機能を追加しながらも、約 40%の低価格化を実現



EP8000 615 model 6C3  
(ラックマウントモデル)



EP8000 615 model 6E3  
(タワーモデル)

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:古川 一夫、以下 日立)は、このたび、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を搭載したエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、最新の POWER4+プロセッサを最大 2 個搭載可能なエントリーモデル「EP8000 615 model 6C3」(ラックマウントモデル)および「EP8000 615 model 6E3」(タワーモデル)をラインアップに追加し、5月30日から販売開始します。

プロセッサに POWER4+(1.2GHz)を搭載(最大 2 個)したことにより、現行の POWER3-II(450MHz)を搭載した「EP8000 610」に比べ、約 1.5 倍の処理性能を実現しました。また、ハイエンドモデルの「EP8000 690」でも採用している障害の発生したプロセッサを自動的に切り離して処理を続行する動的プロセッサ切り離し機能や、PCI バスや PCI アダプタに障害が発生してもシステムリブートを回避してシステムを続行させる PCI バス障害リカバリ機能・動的 PCI アダプタ切り離し機能といった高信頼化機能を追加し、ハイエンドモデルと同等の高い信頼性と可用性(障害回避・対策機能)をエントリークラスでも実現しました。

「EP8000 615」は、このような大幅な処理性能の向上や、高信頼化機能を追加しながらも、価格は「EP8000 610」(450MHz)に比べ、約 40%の低価格化を実現しました。

本製品は、省スペースなタワーモデル「EP8000 615 model 6E3」と、標準ラック筐体(高さ 1.8m)に加え、コンパクトな低層ラック筐体(高さ 1.2m)の利用が可能なラックマウントモデル「EP8000 615 model 6C3」の 2 モデルあります。これにより、中小規模のオフィスなどへの設置が容易で、部門業務システムや小規模な Web システムなどの構築に最適です。

今回のラインアップの追加は、ユーザーがリソースをコアビジネスに集中し、高信頼性かつビジネスの変化に即応した最適なシステムを構築できる環境を提供する日立のサービスプラットフォームコンセプト Harmonious Computing に基づいています。

### 本製品の概要

モデル	形状	プロセッサ	プロセッサ数	キャッシュメモリ	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 615 model 6C3	ラックマウント	POWER4+ (1.2GHz)	1, 2	レベル2 キャッシュ : 1.5MB (1 または 2 プロセッサあたり) レベル3 キャッシュ : 8MB (1 または 2 プロセッサあたり)	1GB ~ 16GB	6
EP8000 615 model 6E3	タワー					

### 価格及び出荷時期

モデル	標準価格	出荷時期
EP8000 615 model 6C3	137 万 9,000 円 ~	1way 構成 : 2003 年 6 月 30 日 ~
EP8000 615 model 6E3		2way 構成 : 2003 年 7 月 31 日 ~

### 製品情報のホームページ

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000>

### 他社所有商標に関する表示

- ・AIX、IBM、POWER4+は、米国およびその他の国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・UNIX は、The Open Group が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

### 本件に関するお問合せ先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ  
 エンタープライズサーバ事業部 企画部【担当:喜多村】  
 〒259 - 1392 神奈川県秦野市堀山下1番地  
 TEL : 0463 - 87 - 6786(ダイヤルイン)

以上

## EP8000 615 model 6C3 / 6E3 の特長

### 1. 最新プロセッサ POWER4+搭載による高い処理性能

「EP8000 615」は、プロセッサを SMP(\*)構成で最大 2 個まで搭載可能なエントリークラスのサーバです。

プロセッサには、線幅0.13マイクロメートルの最新半導体プロセスにより製造され、高い処理性能を実現した最新の POWER4+(1.2GHz)を採用しています。そのため、POWER3- (450MHz)を搭載する現行モデルの「EP8000 610」に、比べ約 1.5 倍の性能向上を実現しています。

SMP : Symmetric Multi-Processor

### 2. 高いシステム拡張性とコンパクトな筐体

メインメモリ容量が最大 16GB、内蔵ハードディスク容量が最大 1,174GB、また拡張 PCI(\*)スロットも高速な PCI-X 規格の拡張スロットを 6 本装備するなどエントリーモデルでありながら高いシステム拡張性を備えています。

筐体は、ラックマウントモデルの「EP8000 615 model 6C3」、タワーモデルの「EP8000 615 model 6E3」の 2 モデルあります。ラックマウントモデルの「EP8000 615 model 6C3」は、高さ 4EIA(178mm)で標準ラック筐体(高さ 1.8m)に最大 9 台搭載可能です。標準ラック筐体に比べ、高さ約 2/3 とコンパクトな低層ラック筐体(高さ 1.2m)も利用でき、中小規模のオフィスなどへの設置も容易です。

PCI: Peripheral Component Interconnect

### 3. メインフレームクラスの高信頼性と可用性(障害回避・対策機能)

「EP8000」シリーズは高信頼性・高可用性を追求したハードウェア設計となっています。「EP8000 615」では信頼性についても現行モデル「EP8000 610」に対し大幅な機能追加を行いました。

プロセッサやキャッシュメモリのエラーが一定回数を超えた場合にそのプロセッサを自動的に切離し、他プロセッサで処理を継続する動的プロセッサ切り離し機能、PCIバスあるいはPCIアダプタ障害によるシステムリブートを回避しシステムの処理を続行する PCI バス障害リカバリ機能、動的 PCI アダプタ切り離し機能など、ハイエンドモデル「EP8000 690」と同等の高信頼・高可用機能を備えています。これによりシステム停止につながる障害発生を大幅に低減し、ユーザーが安心して利用できるシステムを提供します。

### 4. 最新のソフトウェア環境を提供

オペレーティングシステム(OS)として米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム AIX 5L を採用しています。優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能を提供します。

ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェアに加え、DBMS(\*)製品 Oracle<sup>R</sup>や SAP<sup>R</sup> R/3<sup>R</sup>を含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com<sup>R</sup>など豊富な ISV(\*)製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステム構築が可能です。

DBMS: Database Management System

ISV: Independent Software Vendor

### 他社所有商標に関する表示

- ・AIX、IBM、PowerPC は、米国およびその他の国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems Inc.の商標または登録商標です。
- ・ORACLE は、ORACLE Corporation の登録商標です。
- ・SAP R/3<sup>R</sup>、mySAP.com は、SAP AG のドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・UNIX は、The Open Group が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

## 新製品の仕様

モデル		EP8000 615 model 6C3
形状		ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ	POWER4+
	クロック・レート (GHz)	1.2
	プロセッサ数 (way)	1, 2
レベル2キャッシュ(MB *1)		1way構成: 1.5 (1プロセッサあたり) 2way構成: 1.5 (2プロセッサあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		1way構成: 8 (1プロセッサあたり) 2way構成: 8 (2プロセッサあたり)
主記憶容量	最小～最大(GB) *1	1～16
内蔵ディスク容量	最小～最大(GB) *2	36～1,174
拡張PCIスロット本数		6 (PCI-X)
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	483×584×178 (4EIA *3)
	搭載筐体	647×1,138×1,798 (標準ラック筐体) 647×1,138×1,193 (低層ラック筐体)
電源 (V)		100～127/200～240
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率 *4	0.067
	区分	F

モデル		EP8000 615 model 6E3
形状		タワー
プロセッサ	プロセッサ	POWER4+
	クロック・レート (GHz)	1.2
	プロセッサ数 (way)	1, 2
レベル2キャッシュ(MB *1)		1way構成: 1.5 (1プロセッサあたり) 2way構成: 1.5 (2プロセッサあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		1way構成: 8 (1プロセッサあたり) 2way構成: 8 (2プロセッサあたり)
主記憶容量	最小～最大(GB) *1	1～16
内蔵ディスク容量	最小～最大(GB) *2	36～1,174
拡張PCIスロット本数		6 (PCI-X)
外形寸法 (W×D×H:mm)		201×584×533
電源 (V)		100～127/200～240
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率 *4	0.067
	区分	F

\*1: 1MB (メガバイト) = 1,024<sup>2</sup> バイト, 1GB (ギガバイト) = 1,024<sup>3</sup> バイトです。

\*2: 1GB (ギガバイト) = 1,000<sup>3</sup> バイトです。

\*3: ラック搭載時の占有サイズ (1EIA=高さ約 44.5mm)

\*4: 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を, 省エネ法で定める複合理論性能で除した値

---

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

---